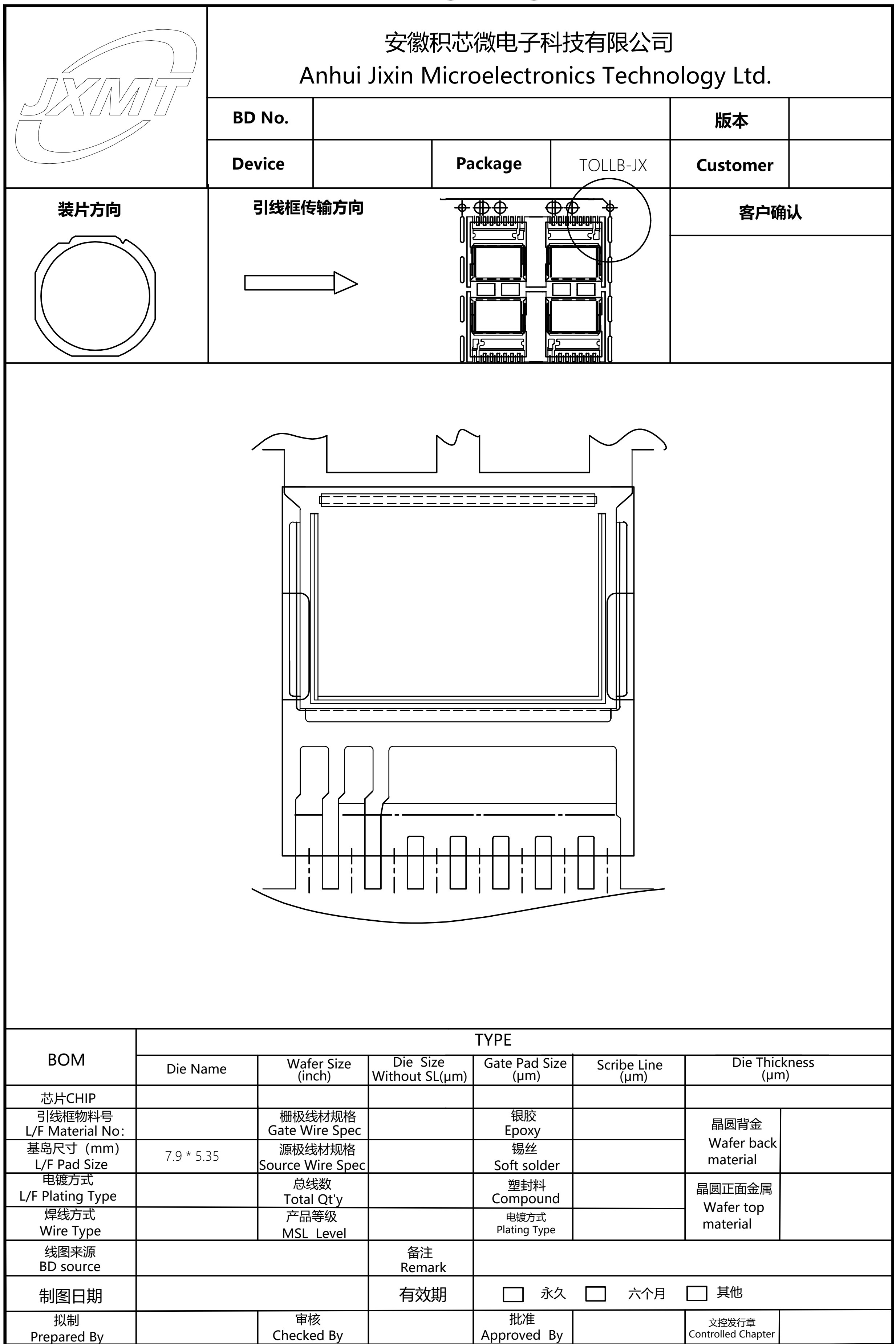
Bonding Diagram



JXMT	安徽积芯微电子科技有限公司 Anhui Jixin Microelectronics Technology Ltd.				
	BD No.			版本	
	Device		Package	TOLLB-JX	Customer
装片方向	引线框传输方向				客户确认

BOM	TYPE						
	Die Name	Wafer Size (inch)	Die Size Without SL(μm)	Gate Pad Size (μm)	Scribe Line (μm)	Die Thickness (μm)	
芯片CHIP							
引线框物料号 L/F Material No:		栅极线材规格 Gate Wire Spec		银胶 Epoxy		晶圆背金 Wafer back material	
基岛尺寸（mm） L/F Pad Size	7.9 * 5.35	源极线材规格 Source Wire Spec		锡丝 Soft solder			
电镀方式 L/F Plating Type		总线数 Total Qt'y		塑封料 Compound		晶圆正面金属 Wafer top material	
焊线方式 Wire Type		产品等级 MSL Level		电镀方式 Plating Type			
线图来源 BD source			备注 Remark				
制图日期			有效期	☐ 永久 ☐ 六个月 ☐ 其他			
拟制 Prepared By		审核 Checked By		批准 Approved By		文控发行章 Controlled Chapter	